

12034

发行量 (印刷版)

公司类型

	%
半导体制造厂商	24.4
半导体封装测试厂商	10.9
计算机/通讯/消费类/汽车/ 医疗电子产品制造商	10.3
半导体制造/测试的设备商	10.1
材料/化学/硬件制造商与销售商	9.1
元件或部件组装	5.3
工业控制系统或设备制造商	5.6
独立的研发实验室	5.0
其他相关领域	4.9
光电元件封装/组装	4.2
使用薄膜技术制造非半导体产品的厂商	3.6
教育机构	3.2
政府及军方单位	2.0
航天、航海、航空、海洋和大气系统或 设备制造商	1.4
总计	100.0

工作类型

	%
公司运营和工程管理	18.5
研发	16.0
封测工艺和生产	8.0
工程技术支持	8.0
工艺开发	7.6
晶圆厂制造工艺和生产	7.5
工厂/设备/维护工程	7.3
可靠性, 品质控制, 评估和测试	7.0
采购	6.1
设备和材料的制造	4.8
设计	3.4
咨询	1.5
其他	4.3
总计	100.0

地区分布

	%
华东	49.7
华南	26.9
华北	11.0
西南	3.9
东北	2.4
华中	3.3
西北	2.0
香港	0.7
总计	100.0